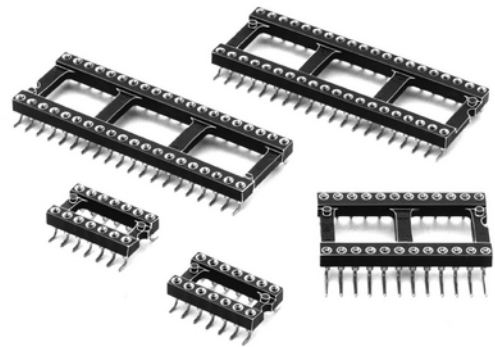


SMT IC-Fassungen RM 2,54mm - Präzisionskontakte in Gull Wing Ausführung SMT IC Sockets 2.54mm Pitch - Gull Wing Screw machined Contacts

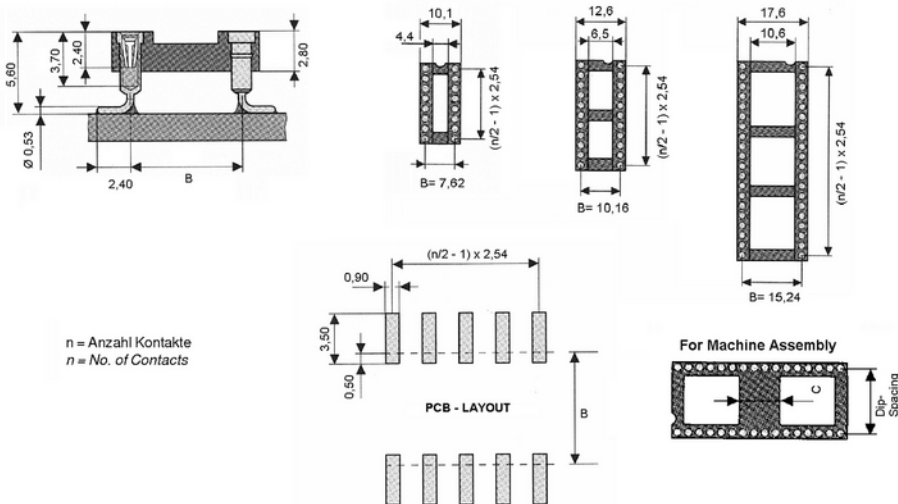
Technische Daten / Technical Data

Gehäuse/Abdeckung/Hebel <i>Case/Cover/Actuator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer <i>Sleeve: screw machined brass</i> <i>Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper</i>
Contact Material	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (2 ... 3µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (2 ... 3µm)</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	IEC 60512-12A
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10mΩ
Contact Resistance	< 10mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV _{RMS}
Test Voltage	1kV _{RMS}
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100V _{RMS} / 150V _{DC}
Voltage Rating	100V _{RMS} / 150V _{DC}
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +125°C
Temperature Range	-55°C ... +125°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Für Rundstifte Ø 0,4 ... 0,56mm
oder Vierkantstifte 0,25 x 0,45mm.
For round pins Ø 0.4 ... 0.56mm
or square pins 0.25 x 0.45mm.



n = Anzahl Kontakte
n = No. of Contacts

For Machine Assembly		
No. of Contact	Dimensions	
	B	C
08	7,62	10,10
14	7,62	10,10
16	7,62	10,10
18	7,62	10,10
20	7,62	10,10
24	7,62	10,10
24	15,24	17,70
28	7,62	10,10
28	15,24	17,70
32	15,24	17,70
40	15,24	17,70

Series	Contacts*	DIP-Spacing*	Assembly*	Sleeve Plating	Clip Plating*	Packing
3240	28 04/06/08/10/ 14/16/18/20/ 22/24/28 =====> 22/24/28/32 =====> 24/28/32/36/ 40/42/48 =====>	4 3 7,62mm 4 10,16mm 6 15,24mm	1 1 Handbestückung <i>Manual assembly</i> 2 Automatenbestückung verfügbare Typen s. Tab. <i>Machine assembly</i> see table for available types	50 50 Verzinkt <i>Tin plated</i>	00 00 Vergoldet <i>Gold plated</i> 10 0,25µm Gold <i>0,25µm gold plated</i> 30 0,75µm Gold <i>0,75µm gold plated</i>	ST ST Verpackt in Stangen <i>Packed in tubes</i>

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperature T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

